

Tentti 10.1.2007, kello 9 ... 12, sali S4

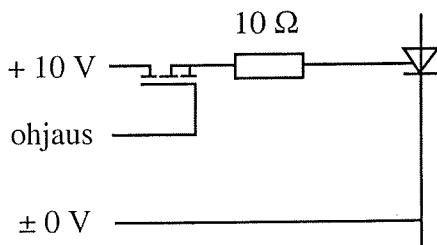
Papereihin

- sukunimi ja etunimet
- opiskelijanumero
- osasto ja vuosikurssi.

Tentissä sallitut apuvälaineet

- kynät, kumit jne.
- taskulaskin
- lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

1. Selvitä lyhyesti (max. 2...4 lausetta + mahdollinen kuva), mitä seuraavilla termeillä tarkoitetaan
 - SiC
 - Schottky-diodi
 - IGCT
 - varistori
 - lähivaikutus.
2. Esittele IGBT:n rakenne, toimintaperiaate ja ominaisuudet.
3. Minkälaisia kondensaattoreita käytetään tehoelektronikkassa? Mitkä ovat niiden ominaisuudet?
4. Tyristorin SKKT 71 hilapulssi vahvistetaan kuvan mukaisella piirillä. MOSFET-transistorin sisäinen vastus R_{DS} on 1Ω . Onko tyristorin syttyminen varmaa -40°C lämpötilassa? Mikä on suurin mahdollinen tyristorin hilahäviöteho, jonka kytkentä voi saada aikaan?

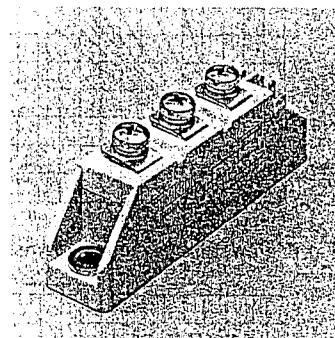


5. Ferriittisydäntä käyttävä muuntaja, jonka häviöteho on $2,5 \text{ W}$, on asennettu piirilevylle siten, että sydän on tiivisti piirilevyä vasten. Muuntajan piirilevyä vasten olevan pinnan pinta-ala on noin 15 cm^2 ja muun osan pinta-ala on noin 70 cm^2 . Muuntajan lämpövästusta arvioidaan kaavalla $R_{th} = 11,7 \text{ } A^{-0,7} P_H^{-0,15}$ jossa R_{th} on lämpövästus, yksikkö K/W, A on pinta-ala neliödesimetriissä ja P_H häviöteho wattaina.
 - a) Mikä on muuntajan lämpövästus, jos sen oletetaan jäähtyvän kaikilta pinnoiltaan?
 - b) Mikä on muuntajan lämpövästus, jos oletetaan ettei piirilevyn kautta johdu lämpöä?
 - c) Mikä on muuntajan alla olevan piirilevyn lämpövästus jos sen paksuus on 2 mm ja lämmönjohtavuus $\lambda = 0,3 \frac{\text{W}}{\text{K m}}$. Oleta, että lämpöä siirryy vain muuntajan kokoiselta alueelta.
 - d) Mikä on muuntajan lämpövästus piirilevyn vaikutus huomioiden?

VRSM V	VRRM V	(dv/ dt)cr V/ μ s	I _{TRMS} (maximum value for continuous operation) 125 A			
			I _{TAV} (sin. 180; T _{case} = 78 °C) 80 A			
700	600	500	SKKT 71/06 D	SKKT 72/06 D	-	SKKH 72/06 D
900	800	500	SKKT 71/08 D	SKKT 72/08 D ¹⁾	SKKH 71/08 D	SKKH 72/08 D
1300	1200	500	SKKT 71/12 D	-	SKKH 71/12 D	-
		1000	SKKT 71/12 E	SKKT 72/12 E ¹⁾	-	SKKH 72/12 E
1500	1400	1000	SKKT 71/14 E	SKKT 72/14 E ¹⁾	SKKH 71/14 E	SKKH 72/14 E
1700	1600	1000	SKKT 71/16 E	SKKT 72/16 E ¹⁾	SKKH 71/16 E	SKKH 72/16 E
1900	1800	1000	SKKT 71/18 E	SKKT 72/18 E	SKKH 71/18 E	-
2100	2000	1000	SKKT 71/20 E	SKKT 72/20 E	SKKH 71/20 E	-

SEMIPACK® 1
Thyristor/ Diode
Modules

SKKT 71 SKKH 71
SKKT 72 SKKH 72
SKKT 72 B



Symbol	Conditions	SKKT 71 SKKH 71	SKKT 72 SKKT 72 B SKKH 72
I _{TAV}	sin. 180; (T _{case} = ...)	80 A (78 °C) 70 A (85 °C)	
I _D	B2/B6 T _{amb} = 35 °C; P 3/180 F	115 A/150 A	
I _{RAMS}	W1/W3 T _{amb} = 35 °C; P 3/180 F	155 A/3 x 115 A	
I _{TSM}	T _{vj} = 25 °C T _{vj} = 125 °C	1600 A 1450 A	
t ² _t	T _{vj} = 25 °C T _{vj} = 125 °C	13000 A ² s 10500 A ² s	
I _{gd}	T _{vj} = 25 °C; I _G = 1 A; dig/dt = 1 A/ μ s	1 μ s	
t _{gr}	V _D = 0,67 · V _{DRM}	2 μ s	
(di/dt)cr	T _{vj} = 125 °C	typ. 100 A/ μ s	
t _q	T _{vj} = 125 °C	typ. 80 μ s	
I _H	T _{vj} = 25 °C;	typ. 150 mA; max. 250 mA	
I _L	T _{vj} = 25 °C; R _G = 33 Ω	typ. 300 mA; max. 600 mA	
V _T	T _{vj} = 25 °C; I _T = 200 A	max. 1,9 V	
V _{T(TO)}	T _{vj} = 125 °C	0,9 V	
I _T	T _{vj} = 125 °C	3,5 mΩ	
I _{DD; IRD}	T _{vj} = 125 °C; V _{DD} = V _{DRM} ; V _{RD} = V _{RRM}	max. 20 mA	
V _{GT}	T _{vj} = 25 °C; d. c.	3 V	
I _{GT}	T _{vj} = 25 °C; d. c.	150 mA	
V _{GD}	T _{vj} = 125 °C; d. c.	0,25 V	
I _{GD}	T _{vj} = 125 °C; d. c.	6 mA	
R _{thjc}	cont. sin. 180 rec.120 } per thyristor/per module	0,35 °C/W / 0,18 °C/W 0,37 °C/W / 0,19 °C/W 0,39 °C/W / 0,20 °C/W 0,2 °C/W / 0,1 °C/W - 40 ... +125 °C - 40 ... +125 °C	
R _{thch}			
T _{vj}			
T _{stg}			
V _{isol}	a. c. 50 Hz; r.m.s.; 1 s/1 min	3000 V~ / 2500 V~	
M ₁	Case to heatsink } SI units/	5 Nm/44 lb. in. \pm 15 % ²⁾	
M ₂	Busbars to terminals } US units	3 Nm/26 lb. in. \pm 15 %	
a		5 · 9,81 m/s ²	
w	approx.	120 g	
Case	→ page B 1 – 85	SKKT 71: A 5	SKKT 72: A 46

¹⁾ The voltage grades SKKT 72/08 D, 12 E, 14 E and 16 E are also available in SKKT ... B configuration
1600 A x 100

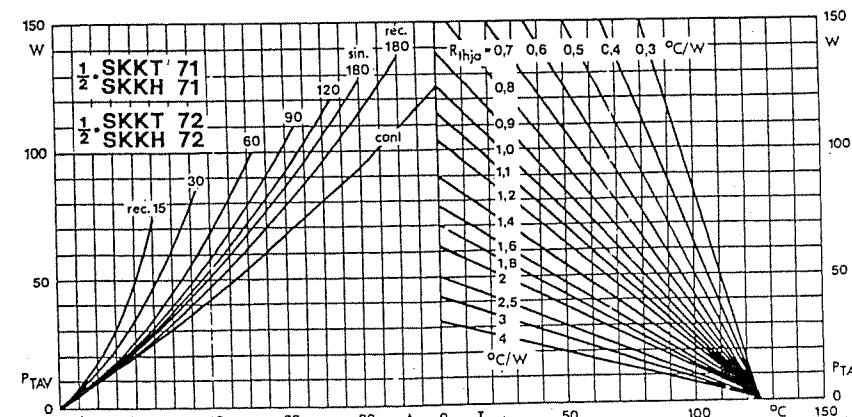


Fig. 1 Power dissipation per thyristor vs. on-state current and ambient temperature

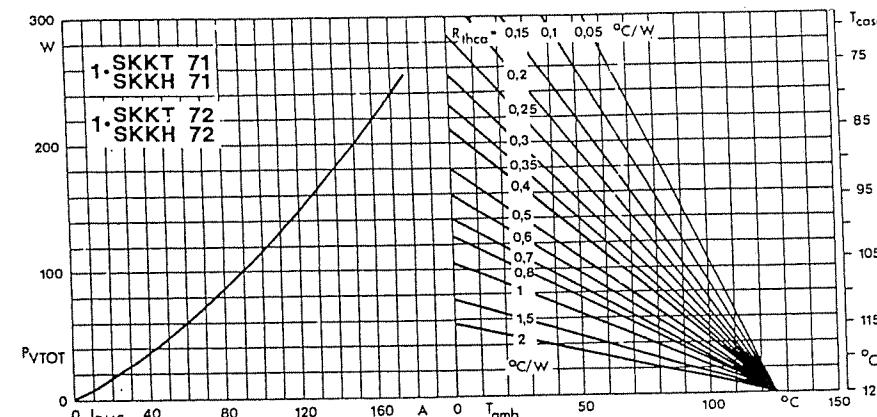


Fig. 2 Power dissipation per module vs. rms current and case temperature

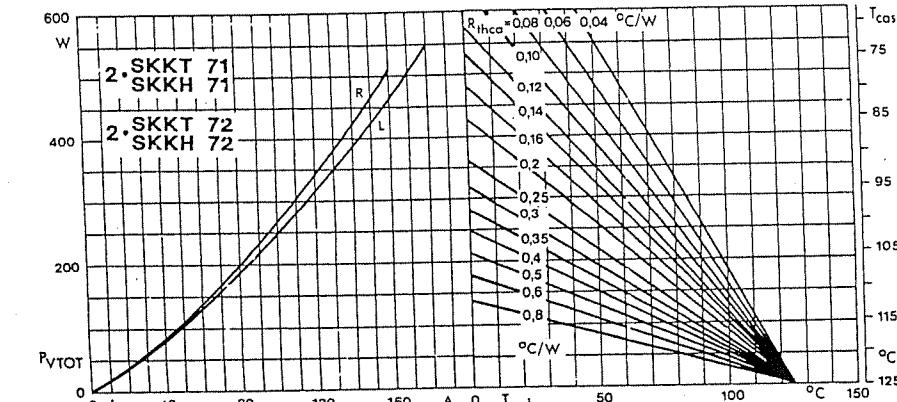


Fig. 3 Power dissipation of two modules vs. direct current and case temperature

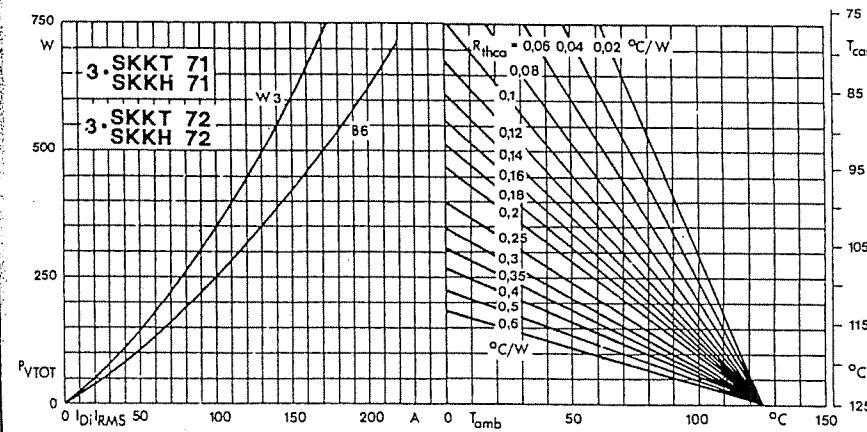


Fig. 4 Power dissipation of three modules vs. direct and rms current and case temperature

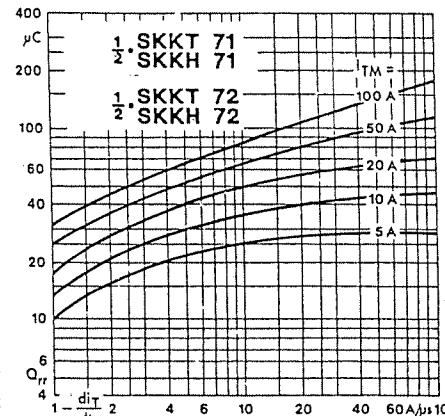


Fig. 5 Recovered charge vs. current decrease

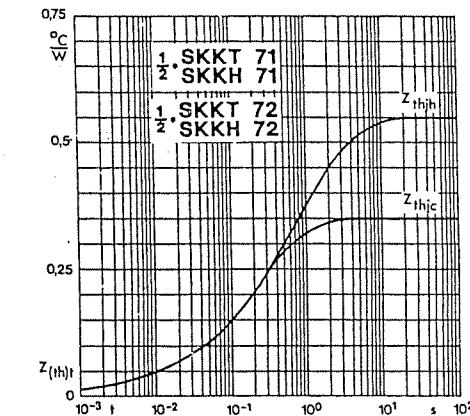


Fig. 6 Transient thermal impedance vs. time

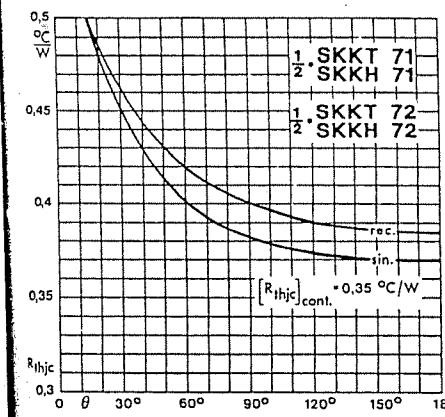


Fig. 7 Thermal resistance vs. conduction angle

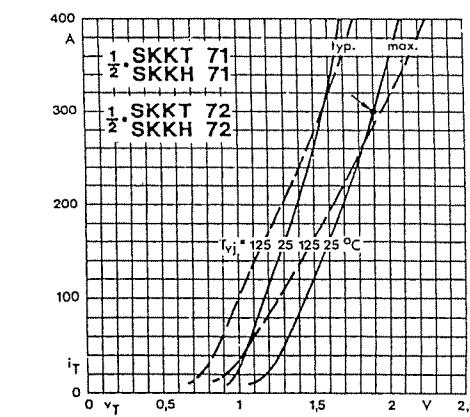


Fig. 8 On-state characteristics

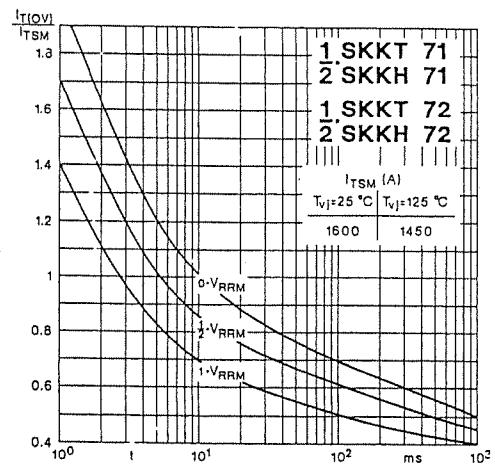


Fig. 9 Surge overload current vs. time

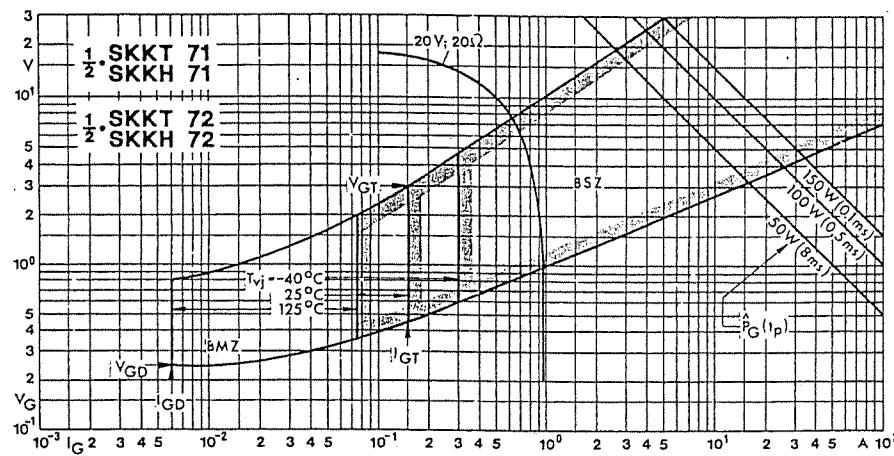


Fig. 10 Gate trigger characteristics

	V_{RSM}
V	
500	
700	
900	
1300	
1500	
1700	
Symb	
I_{TAV}	
I_d	
I_{RMS}	
I_{TSM}	
$2t$	
I_{gd}	
I_{or}	
(di/dt)	
I_q	
I_H	
I_L	
V_T	
$V_T(T_C)$	
τ	
$ I_{DD} $	
V_{GT}	
I_{GT}	
V_{GD}	
I_{GD}	
R_{thjc}	
T_{vj}	
T_{stg}	
V_{iso}	
M1	
M2	
a	
w	
Case	